

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 2 区分
【発行日】平成27年9月3日 (2015.9.3)

【公開番号】特開2014-35428(P2014-35428A)
【公開日】平成26年2月24日 (2014.2.24)
【年通号数】公開・登録公報2014-010
【出願番号】特願2012-176236(P2012-176236)
【国際特許分類】

G 0 2 F 1/1339 (2006.01)

【 F I 】

G 0 2 F 1/1339 5 0 0

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月15日 (2015.7.15)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 2 3
【補正方法】変更
【補正の内容】
【 0 0 2 3 】

また、T F T 1 1 0 基板と C F 基板 1 2 0 はシールパターン 1 3 0 を介して貼り合わされており、表示領域 1 0 0 に配置される柱状スペーサ 1 3 3 により所定の基板間隔に保持されている。更にトランスファ電極と共通電極 1 2 3 は、トランスファ材により電氣的に接続されており、信号端子 1 1 8 から入力された信号が共通電極 1 2 3 に伝達される。トランスファ材については、シールパターン 1 3 0 中に導電性の粒子などを混合することにより代用でき省略することも可能であり、本実施の形態では、導電性の粒子などを混合したシールパターン 1 3 0 を用い、図 2 からも解かるとおりシールパターン 1 3 0 と共通電極 1 2 3 は接触することから、トランスファ電極をシールパターン 1 3 0 に平面的に重なるように配置し、シールパターン 1 3 0 と接触して設けることにより、トランスファ電極と共通電極 1 2 3 についてシールパターン 1 3 0 を介して電氣的に接続した。